

Name	Vorname	Land	Unternehmen	E-mail
Schwientek	Richard	DE	BMW M GmbH Schwientek	richard.schwientek@bmw-m.com
Jirgalke	Alexander	DE	Grimme Landmaschinenfabrik Jirgalke	a.jirgalke@grimme.de
Reuther	Stephan	DE	n-protec additive gmbh Reuther	stephan.reuther@3d-additive.com
Zeller	Noel	DE	Rosswag GmbH Zeller	n.zeller@roswwag-engineering.de
Ziebko	Edward	DE	KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG Ziebko	e.ziebko@kostal.com
Berbalk	Sascha	DE	HEGGMANN AG Berbalk	berbalk@heggemann.com
Rothweiler	Christoph	DE	Aesculap AG Rothweiler	christoph.rothweiler@aesculap.de
Kespe	Michael	DE	Semigator GmbH Kespe	reg_500909_wacker@semigator.de
Lang	Christian	DE	Semigator GmbH Kespe	reg_500909_wacker@semigator.de
Ostermann	Niklas	DE	Ruhr-Universität Bochum Ostermann	Niklas.Ostermann@ruhr-uni-bochum.de
Schwarz	Dennis	DE	BaehrCon Bähr	friedrich.baehr@gmail.com
Elsen	Alex	DE	Heraeus AMLOY Technologies GmbH Elsen	alexander.elsen@heraeus.com
Brand	Michael	DE	Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG Brand	mbrand@boellhoff.com
Pesl	Alexander	AT	IMR Metal Powder Technologies GmbH Pesl	alexander.pesl@imr-metalle.com
Angel	Stefan	DE	SIEMENS Angel	Stefan.angel@siemens.com
Teufel	Thomas	DE	Teufel Prototypen GmbH Teufel	thomas.teufel@teufel-prototypen.de
Geiger	Tobias	DE	Bausch + Ströbel SE & Co. KG Geiger	tobias.geiger@bausch-stroebel.de
Binder	Dr. Maximilian	DE	BMW Group Binder	Maximilian.mb.binder@bmw.de
Fischer	Maximilian	DE	BMW Group Fischer	maximilian.am.fischer@bmw.de
Volek	Andreas	DE	Diehl Stiftung & Co. KG Volek	andreas.volek@diehl.com
Backmeister	Benjamin	DE	WAGO GmbH & Co. KG Backmeister	B.backmeister@gmx.de
Möller	Beata	DE	Danfoss Möller	beata.moeller@web.de
Mayerhofer	Michael	DE	Universität der Bundeswehr München Mayerhofer	michael.mayerhofer@unibw.de
Dröse	André	DE	ArianeGroup GmbH Dröse	andre.droese@ariane.group
Hoetter	Jan-Steffen	DE	Lightway GmbH Hoetter	j.hoetter@lightway.de
Kranich	Pascal	DE	iwis e-tech GmbH Kranich	pascal.kranich@iwis.com
Mayer	Ralph	DE	Headmade Materials GmbH Mayer	r.mayer@headmade-materials.de
Zanzinger	Conrad	DE	Schubert Additive Solutions Zanzinger	c.zanzinger@schubert-additive-solutions.de
Schwarz	Philipp	DE	Rosswag GmbH Schwarz	p.schwarz@roswwag-engineering.de
Ruoff	Maximilian	DE	Weisser Spulenkörper GmbH & Co. KG Ruoff	m.ruoff@weisser.de
Siller	Nadja	DE	Technische Universität Berlin Siller	siller@tu-berlin.de
Müller-ter Jung	Marco	DE	Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Müller-ter Jung	marco.muellerterjung@de.gt.com
Koopmann	Eike Tim	DE	Mercedes-Benz AG Koopmann	eike_tim.koopmann@mercedes-benz.com
Reitemeyer	Daniel	DE	SCANLAB GmbH Reitemeyer	d.reitemeyer@scanlab.de
Pestotnik	Svenja	DE	Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH Pestotnik	svenja.pestotnik@liebherr.com
Braun	Stephan	DE	KSB SE & Co. KGaA Braun	stephan.braun@ksb.com
Steinhoff	Ruben	DE	FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH Steinhoff	steinhoff@funke.de
Zeyn	Helmut	DE	Zeyn Consulting Zeyn	helmut.zeyn@gmail.com
Villmer	Franz-Josef	DE	TH OWL und AM& Villmer	franz-josef.villmer@th-owl.de
ECE	REMZI EC MEL	TR	Turkish Aerospace ECE	reece@tai.com.tr
OGUZ	ALI	TR	Promakim OGUZ	ali.oguz@promakim.com.tr
Cairo	Nicolò	BE	ETN Global Cairo	nc@etn.global
Schaukellis	Max	DE	Roland Berger GmbH Schaukellis	max.schaukellis@rolandberger.com
Lohn	Dr. Johannes	DE	PROTIQ GmbH Lohn	jlohn@protiq.com
Heuser	Karsten	DE	Siemens AG Heuser	karsten.heuser@siemens.com
Lell	Friedemann	DE	DMG MORI Additive GmbH Lell	friedemann.lell@dmgmori.com
Nikolay	Dieter	DE	WZR ceramic solutions GmbH Nikolay	d.nikolay@wzr-ceramic.de
Wykowski	Tomasz	ES	Pelagus 3D Wykowski	tomasz.wykowski@pelagus.com
Engel	Philip	DE	Evonik Operations GmbH Engel	philip.engel@evonik.com
Tasche	Benjamin	DE	Hecht + Dieper Präzisionsspritzguss GmbH Tasche	b.tasche@hecht-dieper.de
Okhovat	Rasool	DE	Technische Universität Berlin Okhovat	rasool.okhovat@tu-berlin.de
Utikal	Sven	DE	Diehl Aviation Laupheim GmbH Utikal	Sven.utikal@diehl.com
Klahn	Christoph	DE	Karlsruhe Institute of Technology Klahn	christoph.klahn@kit.edu
Ott	Michael	DE	Siemens Healthineers AG Ott	ottmichael@siemens-healthineers.com
Tötemeier	Lutz	DE	Ingenieurbüro Tötemeier GmbH Tötemeier	l.toetemeier@ib3d.de
Witt	Gerd	DE	AM Polymers Witt	gerd56.witt@gmail.com
Bähr	Prof. Dr.-Ing. Friedrich	DE	BaehrCon Bähr	friedrich.baehr@gmail.com
Sehrt	Prof. Jan T.	DE	Ruhr-Universität Bochum Sehrt	jan.sehrt@rub.de
ZHANG	SHULIAN	DE	Shenzhen Mingda Technology Co.,Ltd ZHANG	
ZHANG	TONG	DE	Shenzhen Mingda Technology Co.,Ltd ZHANG	
Klemp	Eric	DE	Whitecell Eisenhuth GmbH & Co.KG Klemp	eric@klemp-online.de
Götz	Florian	DE	Ervin Germany GmbH Götz	fgoetz@ervin.eu
Grimm	Tobias	DE	Ruhr-Universität Bochum Grimm	tobias.grimm@ruhr-uni-bochum.de
Süß	Philipp	DE	Ingenieurbüro Süß & friends Süß	philipp@suess-friends.com
de Zeeuw	Erik	BE	Materialise NV de Zeeuw	erik.dezeeuw@materialise.be
Späth	Karl Hannes	DE	KLS Martin SE & Co. KG Späth	kh.spaeth@klsmartin.com
Sax	Manuel	DE	Uni Duisburg Sax	manuel.sax@uni-due.de
Höhenberger	Tanja	DE	KSB SE & Co. KGaA Höhenberger	Tanja.Hoehenberger@ksb.com
Rittinghaus	Bernd	DE	Albrecht Jung GmbH & Co. KG Rittinghaus	b.rittinghaus@jung.de
Polspoel	Wouter	BE	3D Systems Polspoel	wouter.polspoel@3dsystems.com
Cremer	Frank	DE	3D Systems GmbH Cremer	frank.cremer@3dsystems.com
Dieper	Jörg	DE	Hecht + Dieper Präzisionsspritzguss GmbH Tasche	b.tasche@hecht-dieper.de
Maier	Pascal	DE	Robert Bosch GmbH Maier	pascal.maier3@de.bosch.com
Zornek	Anita	DE	KSB SE & Co. KGaA Zornek	anita.zornek@ksb.com
Rühr	Manuel	DE	KSB SE & Co. KGaA Rühr	manuel.ruehr@ksb.com
Widmann	Lisa	DE	Nikon SLM Solutions AG Widmann	Info@nikon-slm-solutions.com
Schlicht	Samuel	DE	Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	samuel.schlicht@fau.de
Dr. Heinemann	Gereon	CH	Exentis Group AG Dr. Heinemann	g.heinemann@exentis-group.com
BARDIN	Pierre	FR	AMPERE Alloys SAS BARDIN	pierre.bardin@amperealloys.com
BOCHEL	Romain	FR	AMPERE Alloys SAS BARDIN	pierre.bardin@amperealloys.com
Stachg	David	DE	HAW Hamburg Stachg	david.stachg@haw-hamburg.de
Carius	Diethelm	DE	VDMA e.V. - HealthTech Carius	diethelm.carius@vdma.org
Dr. Lüders-Theuerkauf	Cora	DE	B.Braun Vascular Systems Berlin Lüders-Theuerkauf	cora.lueders-theuerkauf@bbraun.com
Arango Callejas	Felipe	DE	BMW AG Arango Callejas	felipe.arango-callejas@bmw.de
Krasniqi	Mergim	DE	Physikalisch-Technische Bundesanstalt Krasniqi	mergim.krasniqi@ptb.de
Greimers	Stephan	DE	Dr. Greimers Consulting Greimers	stephan@greimers.de
Gadhiraju	Sreeja	DE	Technische Universität München Gadhiraju	sreeja.gadhiraju@tum.de
Prof. Dr.-Ing. Löber	Lukas	DE	Hochschule Esslinge Löber	lukas.loeber@hs-esslingen.de

Tiefnig	Raphael	AT	Technische Universität Graz Tiefnig	raphael.tiefnig@tugraz.at
Brenner	Stefan	DE	Universität der Bundeswehr München Brenner	stefan.brenner@unibw.de
Nedeljkovic-Groha	Vesna	DE	Universität der Bundeswehr München Nedeljkovic-Groha	vesna.nedeljkovic-groha@unibw.de
Tong	Yiyun	DE	TU Munich Tong	yiyun.tong@tum.de
Mahr	Alexander	DE	Universität Bayreuth Mahr	alexander.mahr@uni-bayreuth.de
Leitz	Karl-Heinz	AT	Plansee SE Leitz	karl-heinz.leitz@plansee.com
Roumeliotis	Paul	DE	Lehrstuhl für Kunststofftechnik; Friedrich Alexander Universität	Paul.Roumeliotis@fau.de
Groneberg	Hajo	DE	Fraunhofer IPA & Universität Bayreuth Groneberg	hajo.groneberg@uni-bayreuth.de
Ankenbrand	Markus	DE	Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl FAPS Ankenbrand	markus.ankenbrand@fap.fau.de
Klier	Kevin	DE	Universität Kassel Klier	klier@uni-kassel.de
Weiss	Özlem	DE	Expertants GmbH Weiss	oezlem.weiss@expertants.com
Di Maglie	Alex	DE	4D Concepts GmbH Di Maglie	ad@4dconcepts.de
Engelhardt	Leon	DE	Rheinische Hochschule Köln Engelhardt	leon.engelhardt@rh-koeln.de
Hoekstra	Jacco	NL	CatIP Hoekstra	j.hoekstra@catip.eu
Kleijnen	Harry	NL	KIAMCO Kleijnen	h.kleijnen@kiamco.nl
Lieneke	Tobias	DE	Universität Paderborn Lieneke	tobias.lieneke@upb.de
Meyer	Lars	DE	Universität Duisburg-Essen Meyer	Lars.meyer@uni-due.de
Haase	Michael	DE	Universität Paderborn Haase	michael.haase@upb.de
Laumen	Marco	DE	Siemens Healthineers Laumen	Marco.Laumen@varian.com
Bräsel	Michael	DE	Siemens Healthineers Laumen	Marco.Laumen@varian.com
Meyer	Marius	DE	Universität Duisburg-Essen Meyer	marius.meyer@uni-due.de
Nicolai	Alexander	DE	Technische Universität Berlin Nicolai	alexander.nicolai@tu-berlin.de
Aktas	Kuntay	TR	Addpark Aktas	kuntay@addpark.co
Heuzeroth	Irena	DE	SKZ KFE gGmbH Heuzeroth	i.heuzeroth@skz.de
Witt	Verena	DE	New AIM3D GmbH Witt	verena.witt@aim3d.de
Lang	Stefan	CH	Irpd AG, St.Gallen Lang	stefan.lang@irpd.ch
Ahnsorge	Tim	DE	TÜV SÜD Industrie Service Ahnsorge	tim.ahnsorge@tuvsud.com
Schmidt	Sebastian	DE	TÜV SÜD Industrie Service Ahnsorge	tim.ahnsorge@tuvsud.com
Pfaff	Aron	DE	Fraunhofer EMI Pfaff	aron.pfaff@emi.fraunhofer.de
Gebhardt	Rainer	DE	VDMA Gebhardt	rainer.gebhardt@vdma.org
Schonefeld	Hendrik	NL	Additive Industries B.V. Schonefeld	h.schonefeld@additiveindustries.com
Bernstein	Ronny	DE	BMF GmbH Bernstein	ronny.bernstein@bmfgmbh.de
Birk	Kai	DE	Mapal Dr. Kress KG Birk	kai.birk@mapal.com
Tschorn	Thorben	DE	Bayern Innovativ GmbH Tschorn	thorben.tschorn@bayern-innovativ.de
Hajsek	Melissa	DE	Bayern Innovativ GmbH Hajsek	melissa.hajsek@bayern-innovativ.de
Roth	Stefan	DE	Hochschule Schmalkalden Roth	s.roth@hs-sm.de
Müller	Bernhard	DE	Fraunhofer IWU Müller	bernhard.mueller@iwu.fraunhofer.de
Dr. Völger	Wolfgang	DE	KNPP PartGmbH Dr. Völger	voelger@knpp.de
Papke	Thomas	DE	Schaeffler Technologies AG & Co. KG Papke	papketom@schaeffler.com
Kögler	Albrecht	DE	Materialise GmbH Kögler	albrecht.koegler@materialise.de
vom Stein	Peter	DE	RI Research Instruments GmbH vom Stein	peter.vomstein@research-instruments.de
Zwiebel	Jan	DE	GEFERTEC GmbH Zwiebel	jan.zwiebel@gefertec.de
Strobel	Marcel	DE	Headmade Materials GmbH Strobel	m.strobel@headmade-materials.de
Gasch	Martin	DE	Siemens Industry Software GmbH Gasch	martin.gasch@siemens.com
Oster	Joerg	DE	AddUp GmbH Oster	joerg.oster@addupsolutions.com
Goetze	Wolf	DE	Bauer Kompressoren GmbH Goetze	w.goetze@bauer-kompressoren.de
Stolpe	Moritz	DE	Moritz Stolpe Consulting Stolpe	moritzstolpe@gmx.de
Eichmann	Michael	DE	Stratasys GmbH Eichmann	michael.eichmann@stratasys.com
Pohlisch	Volker	DE	Vitesco Technologies Germany GmbH Pohlisch	volker.pohlisch@vitesco.com
Kelbassa	Ingomar	DE	IAPT Fraunhofer Hamburg Kelbassa	martina.rogge@iapt.fraunhofer.de
Eisentraut	Mark	DE	CHESCO GmbH Eisentraut	mark.eisentraut@chesco.de
Gehringner	Martin	DE	Siemens AG Gehringner	martin.gehringer@siemens.com
Freiwald	Lutz	DE	Axenoll 3D Printing GmbH Freiwald	l.freiwald@axenoll.com
Freiwald	Lutz	DE	Axenoll 3D Printing GmbH Freiwald	l.freiwald@axenoll.com
Henschel	Nicolai	DE	Magna Henschel	henschelnicolai@gmail.com
Zhu	Dongjian	DE	GKN Powder Metallurgy GmbH Zhu	dongjian.zhu@gknpm.com
Merklein	Carsten	DE	Schaeffler Technologies AG & Co. KG Merklein	carsten.merklein@schaeffler.com
Pröbsting	Johannes	DE	Gottinger Handelshaus OHG Pröbsting	jnp@gottinger.de
Schumacher	Ralf	CH	BellwaldTEC Schumacher	ralf.schumacher@bellwaldtec.ch
Simon	Dirk	DE	Simon-in-AM Consulting Simon	dirk.simon0@gmail.com
Ortmann	Claudia	DE	Enovis Mathys Orthopaedie GmbH Ortmann	Claudia.Ortmann@enovis.com
Ruta	Marc	DE	WILDDesign GmbH Ruta	marc.ruta@wilddesign.de
Kashevko	Vasyl	DE	Rocket Factory Augsburg Kashevko	vasyl.kashevko@rfa.space
Mergner	Doro	DE	MSWtech Mergner	doro.mergner@mswtech.de
Jahn	Simon	DE	ifw Jena Jahn	sjahn@ifw-jena.de
Nawrot	Witold	PL	XTPL Nawrot	witold.nawrot@xtpl.com
Hoffmann	Martin	DE	toolcraft	madlenhirschmann@toolcraft.de
Coenen	Franc	NL	3D print magazine	franc.coenen@3dprintmagazine.eu
Kowen	Joseph	ISR	Associate Author	joseph.kowen@intelligent-am.com
Huber	Tilman	DE	AUTOCAD Magazin Medien	tilmann.huber@win-verlag.de
Kostelnik	Jan	DE	Eugen G. Leuze Verlag	jan.kostelnik@tebko.de
Schmidtpeter	Antje	DE	Meisenbach GmbH Verlag	antje.schmidtpeter@meisenbach.de
Michal	Tilo	DE	UMFORMTECHNIK MASSIV+LEICHTBAU: Meisenbach	tilo.michal@meisenbach.de
Cordes	Heiko	DE	Verlag Orthopädie-Technik	heiko.cordes@biv-ot.org
Pfeiffer	Juliana	DE	Vogel Communications Group	juliana.pfeiffer@vogel.de
Müller	Andreas	DE	WIN Verlag GmbH & Co. KG	andreas.mueller@win-verlag.de
Schöpf	Georg	AT	x-technik Industriemedien GmbH	georg.schoepf@x-technik.com
Masuch	Thomas	DE	Zikomm	thomas.masuch@zikomm.de
Radig	Guido	DE	Prouvido	radig@prouvido.com
Moser	Daniel	DE	Umformtechnik Massiv-Leichtbau Meisenbach Verlag	daniel.moser@meisenbach.de
Käfer	Simone	DE	Add Mag	simone.kaefer@schluetesche.de
Stückl	Andreas	DE	Add Mag	andreas.stueckl@schluetesche.de
Jentsch	Bernd	DE	Funk Medien	bernd.jentsch@funkemedien.de
Krapp	Mattis	DE	Funk Medien	
Minard	Susan	DE	mdr Thüringen Journal	susan.minard@mdr.de
Müller	Lothar	DE	THEMEN!magazin	dr.mueller@themen-magazin.de
Vogt	Maximilian	DE	Fraunhofer Research Institution for Additive Manufacturing	maximilian.vogt@iapt.fraunhofer.de
Zeck	Paul	DE	Hochschule Esslingen Zeck	pazemt00@hs-esslingen.de
Jahnke	Ulrich	DE	Additive Marking GmbH Jahnke	jahnke@additive-marking.de

Lakomec	Dr. Marius	DE	EOS GmbH Lakomec	marius.lakomec@eos.info
Dixneit	Jonny	DE	Siemens Energy Dixneit	jonny.dixneit.ext@siemens-energy.com
Evdokimov	Anton	DE	heatshape GmbH Evdokimov	anton.evdokimov@heatshape.de
Teurich	Andreas	DE	Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Teurich	andreas.teurich@siemens-energy.com
Habdank	Matthias	DE	Additive Marking GmbH Habdank	matthias.habdank@additive-marking.de
Ritter	Matthias	DE	Siemens Energy - Görlitz Ritter	matthias.mr.ritter@siemens-energy.com
Alberts	Daniel	DE	Consulting, Interim Management & Investments Alberts	danielalberts@gmx.net
Ghaffarzadeh	Khasha	DE	KGH Concepts GmbH Ghaffarzadeh	khasha@TechBlick.com
Schreiber	Michael	DE	OTH Regensburg Schreiber	michael.schreiber@st.oth-regensburg.de
Kolbe	Christian	DE	FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH Kolbe	christian.kolbe@fkt-triptis.de
Schäfer	Martin	DE	Siemens AG Schäfer	martin.schaefer@siemens.com
Neuberger	Cosima	DE	F. Gottinger Orthopädietechnik GmbH Neuberger	cosima.neuberger@gottinger.de
Leschinski	Patrick	CH	Conteo AG Leschinski	patrick.leschinski@conteo.io
Seifert	Anton	DE	IPF Dresden Seifert	seifert-anton@ipfdd.de
Cholewa	Simon	DE	Lehrstuhl für Kunststofftechnik Erlangen Cholewa	simon.cholewa@fau.de
Seidel	Christian	DE	Hochschule München / Wohlers Associates Seidel	christian.seidel@hm.edu
Gebauer	Mathias	DE	Fraunhofer IWW Gebauer	mathias.gebauer@iww.fraunhofer.de
Kragl	Timm	DE	Phanos GmbH Kragl	t.kragl@phanos3d.com
Neumann	U.	DE	4D Concepts GmbH Neumann	un@4dconcepts.de
Henrichs	Niclas	DE	Impetus Plastics Engineering GmbH Henrichs	n.henrichs@impetus-engineering.de
Geßner	Paul	DE	Hochschule Anhalt Geßner	paul.gessner@hs-anhalt.de
Schatton	Raphael	DE	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Schatton	raphael.schatton@sanofi.com
Wiesner	Valentin	DE	TTZ HS-Coburg Wiesner	valentin.wiesner@hs-coburg.de
Rohr	Olivier	DE	Isar Aerospace SE Rohr	Olivier.rohr@gmx.de
Lautenschläger	Marcus	DE	FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH Lautenschläger	Marcus.Lautenschlaeger@fkt-triptis.de
Schleifenbaum	Johannes Henrich	DE	Lehrstuhl DAP RWTH Aachen Schleifenbaum	office@dap.rwth-aachen.de
Ostermann	Niklas	DE	Ruhr-Universität Bochum Hybrid Additive Manufakturing	niklas.ostermann@ruhr-uni-bochum.de
Willkomm	Johannes	DE	RWTH Aachen University - Digital Additive Production D	johannes.willkomm@dap.rwth-aachen.de
Jankowiak	Mirco	DE	Fraunhofer IAPT Jankowiak	Mirco.jankowiak@iapt.fraunhofer.de
Vögtel-Miebach	Dominik	CH	Samaplast AG Vögtel-Miebach	dominik.miebach@samaplast.ch
Vögtel-Miebach	Dominik	CH	Samaplast AG Vögtel-Miebach	dominik.miebach@samaplast.ch
Mayr	Peter	DE	TUM - Lst. Werkstofftechnik der AF Mayr	peter.mayr@tum.de
Köster	Antonius	DE	Antonius Köster GmbH & Co. KG Köster	ak@innovative-cad-cam-solutions.com
Plettner	Tom	DE	Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden Plettner	plettner@ipfdd.de
Wegner	Andreas	DE	AM POLYMERS GmbH Wegner	a.wegner@am-polymers.de
Bräunig	Jan	DE	Fraunhofer IIS Bräunig	jan.braeunig@iis.fraunhofer.de
Tillmann	Linus	DE	MGA - Mobility goes Additive e.V. Tillmann	linus.tillmann@mga-net.com
Frei	Manuel	CH	Samaplast AG Frei	manuel.frei@samaplast.ch
Taylor	Justin	DE	AM Solutions Taylor	j.taylor@rosler.com
Hauck	Christoph	DE	toolcraft AG Hauck	christophhauck@toolcraft.de
Doerffel	Christoph	DE	Steinbeis Innovationszentrum ALP Doerffel	christoph.doerffel@stw.de
Weigand	Aliah	DE	AM Solutions Weigand	a.weigand@rosler.com
Stepien	Lukas	DE	Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IV	lukas.stepien@iws.fraunhofer.de
Auernhammer	Stefan	DE	toolcraft AG Auernhammer	stefanauernhammer@toolcraft.de
Krasniqi	Mergim	DE	Physikalisch-Technische Bundesanstalt Krasniqi	mergim.krasniqi@ptb.de
Brunner	Enrico	CH	Sauber Motorsport AG Brunner	Enrico.brunner@sauber-group.com
Sousa	Vitor	CH	Sauber Motorsport AG Sousa	vitor.sousa@sauber-group.com
Pensel	Hans Georg	DE	EAH-Jena Pensel	HansGeorg.Pensel@eah-jena.de
Nüßlein	Jonas	DE	TTZ Oberfranken an der Hochschule Coburg Nüßlein	jonas.nuesslein@hs-coburg.de
Cabilly	Itai	IL	Tel Aviv University Cabilly	itaicabilly@gmail.com
Oved	Hadas	IL	Tel Aviv University Oved	Hadasoved@mail.tau.ac.il
Köstler	Nico	DE	Universität Bayreuth Köstler	nico.koestler@uni-bayreuth.de
Risch	Florian	DE	FAU Erlangen-Nürnberg Risch	florian.risch@faps.fau.de
Schönrrath	Hanna	DE	Universität Duisburg-Essen Schönrrath	hanna.schoenrrath@uni-due.de
Bähr	Markus	DE	Diehl Defence GmbH Bähr	markus.baehr@diehl-defence.com
Schmidt-Lehr	Matthias	DE	AMPOWER GmbH & Co. KG Schmidt-Lehr	schmidt-lehr@ampower.eu
Kleszczynski	Stefan	DE	Universität Duisburg-Essen Kleszczynski	stefan.kleszczynski@uni-due.de
Pendzik	Martin	DE	TU Dresden (Virtuelle Produktentwicklung) Pendzik	martin.pendzik@tu-dresden.de
Sembdner	Philipp	DE	TU Dresden Sembdner	philipp.sembdner@tu-dresden.de
Zeidler	Stephan	NL	Additive Industries Zeidler	s.zeidler@additiveindustries.com
Mangold	Mikel	DK	ATLANT 3D Mangold	mman@atlant3d.com
Stanley	John	DE	Indo-mim Stanley	john.s@indo-mim.com
Oberkönig	Henrik	DE	Ruhr-Universität Bochum / Lehrstuhl Hybrid Additive Man	henrik.oberkoenig@ruhr-uni-bochum.de
Hampel	Udo	DE	AM Solutions Hampel	u.hampel@rosler.com
Riedl	Edmund	DE	Infineon Technologies AG Riedl	edmund.riedl@infineon.com
Dusel	Karl-Heinz	DE	MTU Aero Engines AG Dusel	karl-heinz.dusel@mtu.de
Franschitz	Stefan	AT	Magna Cosma Engineering Europe Franschitz	stefan.franschitz@magna.com
Hornung	Jakob	DE	TTZ Oberfranken Hornung	jakob.hornung@hs-coburg.de
Ciprian	Andreas	DE	BMW Group Ciprian	Andreas.Ciprian@bmw.de
Nier	Dennis	DE	Siemens Nier	dennis.nier@siemens.com
Sabisch	Rainer	DE	TITAL GmbH Sabisch	rainer.sabisch@howmet.com
Huls	David	DE	SPALECK Oberflächentechnik GmbH Huls	D.huls@spaleck.biz
Hughes	Liam	DE	Universität Bayreuth Mahr	alexander.mahr@uni-bayreuth.de
Gaedike	Bastian	DE	Malping GmbH Gaedike	bastian@malping.de
Jedynak	Angelika	DE	CHESCO GmbH Jedynak	angelika.jedynak@chesco.de
Neumann	Tom	DE	4D Service & Consulting GmbH Neumann	tom@4dsc.xyz
Wagner	Jochen	AT	M&H CNC Technik GmbH Wagner	jochen.wagner@mhcnc.com
Herzog	Jan-Frederik	DE	Evonik Operations GmbH Herzog	jan-frederik.herzog@evonik.com
Mayer	Philipp	DE	Schaeffler Technologies Ag & Co KG Mayer	Philipp.mayer@schaeffler.com
Groh	Wolfram	DE	TU Dresden Groh	wolfram.groh@tu-dresden.de
Strobel	Thomas	DE	IAMT Engineering Strobel	nicole.richter@iamt-gruppe.de
Wendzel	Pascal	DE	pro-beam GmbH & Co.KGaa Wendzel	pascal.wendzel@pro-beam.com
Fruth	Carl	DE	Fit AG Fruth	Carl.fruth@fit.technology
Kunkel	Maximilian	DE	Siemens Mobility GmbH Kunkel	maximilian.kunkel@siemens.com
Masuch	Thomas	DE	ASTM Masuch	tm@wohlersassociates.com
Wolcke	Gunther	DE	ifw Jena Wolcke	gwolcke@ifw-jena.de
Streinz	Maximilian	DE	ifw Jena Streinz	mstreinz@ifw-jena.de
Guhl	Leonard	DE	ifw Jena Guhl	lguhl@ifw-jena.de
Melnikow	Dennis	DE	ifw Jena Melnikow	dmelnikow@ifw-jena.de

Beckmann	Frank	DE	Beckmann	frank.beckmann@iapt.fraunhofer.de
Tschernig	Martin	DE	Reha aktiv GmbH Willms	Nicole.Willms@reha-aktiv.com
Held	Tom	DE	Reha aktiv GmbH Willms	Nicole.Willms@reha-aktiv.com
Yang	Hao	DE	UnionTech Yang	hao.yang@uniontech3d.com
Siah	Kok Siong	DE	Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktions	KokSiong.Siah@faps.fau.de
Krause-Broßmann	H.	DE	PORTEC GmbH Krause	krause@portec-gmbh.de
Doleschel	Dominik	DE	Universität Augsburg / Hochschule München Doleschel	dominik@doleschel.com
Warner	Pat	GB	Alpine Racing Warner	pat.warner@alpinef1.com
Hofer	Michael	AT	MostTech e.U. Hofer	info@mosttech.at
Marschall	Maximilian	DE	Bayerisches Laserzentrum GmbH Marschall	m.marschall@blz.org
Marschall	Maximilian	DE	Bayerisches Laserzentrum GmbH Marschall	m.marschall@blz.org
Nußbaumer	Frederik	DE	AM Pioneers GmbH Nußbaumer	frederik.nussbaumer@am-pioneers.com
Nitsche	Erik	DE	AM Pioneers GmbH Nitsche	nitsche897@gmail.com
Bolm	Dennis	DE	Invent Medical Deutschland GmbH Bolm	dennis@inventmedical.com
Wille	Toni	DE	Ernst-Abbe-Hochschule Jena Wille	toni.wille@eah-jena.de
Herrmann	Dennis	DE	DH Innovation Herrmann	Dh@dh-innovation.com
Herrmann	Dennis	DE	DH Innovation Herrmann	Dh@dh-innovation.com
Wissink	Luuk	NL	K3D B.V. Wissink	lwissink@k3d.nl
Ezzine	Wejdane	DE	AM Pioneers GmbH Ezzine	wejdane.ezzine@am-pioneers.com
Beyer	Dr. Steffen	DE	ArianeGroup GmbH (Airbus) Beyer	steffen.beyer@ariane.group
Prestien	Ingrid	DE	CIPRES GmbH Prestien	sales@cipres.biz
Wagner	Michael	DE	Helmholtz Institut Erlangen Nürnberg Wagner	mic.wagner@fz-juelich.de
Walter	Dominik	DE	pedcad foot technology GmbH Walter	dominik.walter@pedcad.de
Siebert	Ludovic	DE	Mercedes-Benz AG Siebert	ludovic.siebert@mercedes-benz.com
Stremme	Noah	DE	EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG Stremme	noah.stremme@eagleburgmann.com
Holze	Carsten	DE	Pioneer Aeronautics Innovation GmbH Holze	carsten.holze@machtwissen.de
Angenooth	Jan	DE	Fraunhofer IGCV Angenooth	jan.angenooth@igcv.fraunhofer.de
Geitner	Thomas	DE	FIT AG Geitner	thomas.geitner@pro-fit.de
Behrens	Christoph	DE	Universität Bremen Behrens	behrens@isemp.de
Weiss	Alex	DE	Mercedes-Benz AG Weiss	Alexander.aw.weiss@mercedes-benz.com
Kruse	Keno	DE	Oqton Kruse	keno.kruse@oqton.com
Hampel	David	DE	Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH Ham	david.hampel@berlin-partner.de
Baehr	Erik	DE	Oerlikon Metco Europe GmbH Baehr	erik.baehr@oerlikon.com
Röttinger	Matthias	DE	Universität Bayreuth Röttinger	Matthias.Roettinger@uni-bayreuth.de
Bonke	Alexander	DE	FIT AG Bonke	alexander.bonke@fit.technology
Linnenberg	Markus	DE	Fraunhofer-Institut, Ernst-Mach-Institut Freiburg Linnenbe	markus.linnenberg@emi.fraunhofer.de
Meinhardt	Rafael	DE	Fraunhofer IAPT Meinhardt	rafael.meinhardt@iapt.fraunhofer.de
Zeidler	Henning	DE	TU Bergakademie Freiberg Zeidler	henning.zeidler@imkf.tu-freiberg.de
Itahriouan	Safouan	DE	Oqton Itahriouan	safouan.itahriouan@oqton.com
Frei	Manuel	CH	Samaplast AG Frei	manuel.frei@samaplast.ch
Jain	Peter	DE	Pro Beam Additive GmbH Jain	peter.jain@pro-beam.com
Ritt	Stefan	DE	Messe Erfurt GmbH Keucher	d.keucher@messe-erfurt.de
Kemnitzer	Jan	DE	Fraunhofer IPA Kemnitzer	jan.felix.kemnitzer@ipa.fraunhofer.de
Zimmerer	Markus	DE	Smart Manufacturing Lab / Hochschule München Zimmer	zimmerer.markus@hm.edu
Büse	Hans-Ulrich	DE	Blue Production GmbH & Co. KG Büse	ubuese@blue-production.de
Mapari	Hrushikesh	DE	Ansys Germany GmbH Mapari	hrushikesh.mapari@ansys.com
Nowotnick	Jonas	DE	Merantix Momentum GmbH Nowotnick	jonas.nowotnick@merantix-momentum.com
Fritzsche	Sven	DE	Fritzsche	Sven.fritzsche@mga-net.com
Kruse	Henrik	DE	RWTH Aachen University -Digital Additive Production DA	henrik.kruse@dap.rwth-aachen.de
Vu	Hoang Minh	DE	Technische Universität Darmstadt Vu	hoang_minh.vu@tu-darmstadt.de
Köhler	Lena	DE	schubert und braun prothesenwerk gmbh Köhler	lena.koehler@prothesenwerk.com
Hinkers	Lily	DE	Uni Duisburg Hinkers	lily.hinkers@gmail.com
Sander	Jörg	DE	Hensoldt Sensors GmbH Sander	
Rehlinger	Phil Maurice	DE	Rehlinger	phil.maurice98@icloud.com
Hayashi	Eishin	DE	JEOL Hayashi	hayashi@jeol.de
Neff	Martin	DE	Messe Erfurt GmbH Kern	v.kern@messe-erfurt.de
Üzümcü	Yusuf	ES	ArcelorMittal Powders, S.L. Üzümcü	yusuf.uzumcu@arcelormittal.com
Brasch	Johannes	DE	Smart Manufacturing Lab / Hochschule München Brasch	brasch.johannes@hm.edu
Tünnermann	Andreas	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Haber	Patrick	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Palm	Frank	DE	Airbus CRT Palm	frank.palm@airbus.com
Ahlers	Dominik	DE	Nikon SLM Solutions AG Ahlers	dominik.ahlers@nikon-slm-solutions.com
Rothmeier	Marvin	DE	Karlsruher Institut für Technology Rothmeier	marvin.rothmeier@kit.edu
Gajek	Patrick	DE	Karlsruher Institut für Technology Rothmeier	marvin.rothmeier@kit.edu
Mildner	Wolfgang	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Langefeld	Dr. Bernhard	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Falk	Mareike	DE	toolcraft AG Falk	mareikefalk@toolcraft.de
Vu	Hoang Minh	DE	Technische Universität Darmstadt Vu	hoang_minh.vu@tu-darmstadt.de
Peleg	Danit	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Falk	Mareike	DE	toolcraft AG Falk	mareikefalk@toolcraft.de
Glinski	Dennis	DE	Glinski Glinski	glinski.de@gmail.com
Kiener	Dr. Christoph	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	escheberg@erfurt-messe.de
Nguyen	Xuan	DE	Shapfab GmbH & Co. KG. Nguyen	xuan.nguyen@shapfab.de
Heinz	Nikolaus	DE	ShapFab GmbH & Co. KG Heinz	nikolaus.heinz@shapfab.de
Diederich	Patrick	DE	DMG MORI ULTRASONIC LASERTEC GmbH Diederich	silke.glaser@dmgmori.com
Schlick	Georg	DE	Fraunhofer IGCV Schlick	georg.schlick@igcv.fraunhofer.de
Stahn	Sebastian	DE	Ansys Stahn	Sebastian.stahn@googlemail.com
de Calan	Guillaume	FR	NANOE de Calan	G.decalan@nanoe.com
Wittmann	Stefan	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	escheberg@erfurt-messe.de
Scheithauer	Uwe	DE	Fraunhofer IKTS Scheithauer	uwe.scheithauer@ikts.fraunhofer.de
Bähr	Thomas	DE	BaehrCon Bähr	friedrich@baehrcon.de
Kilian	Arwed	DE	Trumpf SE Kilian	arwed.kilian@trumpf.com
Sax	Manuel	DE	Uni Duisburg Sax	manuel.sax@uni-due.de
Kuhn	Steffen	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	escheberg@erfurt-messe.de
Such	Anders	DE	MAN Energy Solutions SE Such	anders.such@man-es.com
Pammer	Sebastian	DE	3D Systems Pammer	sebastian.pammer@3dsystems.com
Bähr	Sabine	DE	BaehrCon Bähr	friedrich@sequoia-outdoor.de
Röhrich	Tobias	DE	BTU Cottbus Röhrich	roehrich@b-tu.de
Mangold	Mikel	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de

Hirschmann	Madlen	DE	toolcraft AG Hirschmann	madlen.h71@gmx.de
Obernöder	Manuel	DE	toolcraft AG Obernöder	madlen.h71@gmx.de
Schwarze	Dr. Dieter	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Schwarze	Ulrike	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Fischer	Jakob	DE	Heraeus Fischer	jakob.fischer@heraeus.com
Garscha	Markus	DE	Ossberger Garscha	Garscha@ossberger.de
Brickwede	Stefanie	DE	Messe Erfurt GmbH Abendkasse	kontakt@ticketshop-thueringen.de
Tschorn	Hagen	DE	Canto Ing. GmbH Tschorn	Tschorn@canto-web.de
Kessler	Julia	DE	IWF Kessler	j.kessler@iwf-research.de
Schwarz	Alexander	DE	IwF GmbH Schwarz	A.schwarz@iwf-research.de
Piegert	Sebastian	DE	Siemens Energy Piegert	sebastian.piegert@siemens-energy.com
Sipan	Ücün	DE	TU Chemnitz Sipan	sipanucun@gmail.com
Gebhardt	Andreas	DE	FH Aachen Gebhardt	A.schwarz@fh-aachen.de
Wille	Marcel	DE	Anuplastology - Care Wille	i.wille@epithetikerin.de
Wille	Inge	DE	Anuplastology - Care Wille	i.wille@epithetikerin.de
Ostermann	Niklas	DE	Ruhr-Universität Bochum Ostermann	Niklas.Ostermann@ruhr-uni-bochum.de
Götz	Florian	DE	Ervin Germany GmbH Götz	fgoetz@ervin.eu
Wolf	Philip	CH	ETH Zürich Wolf	phwolf@ethz.ch
Schwarz	Dennis	DE	BaehrCon Bähr	friedrich.baehr@gmail.com
Oberkönig	Henrik	DE	Ruhr-Universität Bochum / Lehrstuhl Hybrid Additive Man	henrik.oberkoenig@ruhr-uni-bochum.de
Peleg	Danit	PT	Danit Peleg 3D Peleg	danitpeleg@gmail.com
Velten	Andreas	DE	IFA3D Medical Solutions GmbH Velten	av@ifa3d.com
Shifman	Alexey	NL	Royal3D B.V. Shifman	info@royal3d.nl
de Reus	Bob	NL	Royal3D B.V. Shifman	info@royal3d.nl
Ferretti Martarello	Ana	DE	Willowprint Ferretti Martarello	anamartarello@gmail.com
Marschall	Maximilian	DE	Bayerisches Laserzentrum GmbH Marschall	m.marschall@blz.org
Meyer	Joost	DE	Willowprint Meyer	jmeyer@la.rwth-aachen.de
Toussaint	Laurin	DE	RWTH Willowprint Toussaint	laurin.toussaint@rwth-aachen.de
Hofmann	Urs	CH	inspire AG Hofmann	urs.hofmann@inspire.ch
Beutler	Patrick	CH	inspire AG Hofmann	urs.hofmann@inspire.ch
Dörrie	Robin	DE	Institut für Tragwerksentwurf Dörrie	r.doerrie@tu-braunschweig.de
Garrido	Federico	DE	Willowprint Garrido	federgarrido@gmail.com
Van Glabeke	Thomas	NL	MX3D Van Glabeke	thomas@mx3d.com
Grüne	Emilia	DE	Willowprint Grüne	emilia.gruene@rwth-aachen.de